



厚膜チップ抵抗器の抵抗値トリミングをより高速、  
高精度に最適なソリューションを提供します

## HIPA 厚膜レーザートリマーの特徴

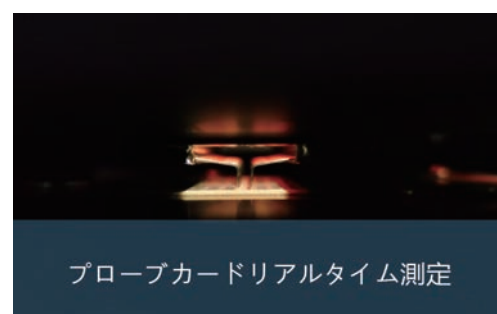
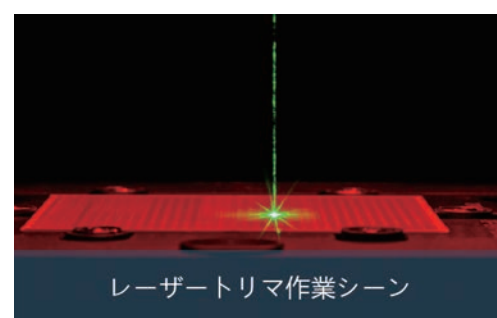
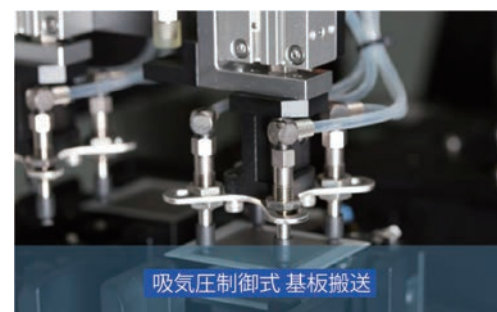
HIP 厚膜用レーザートリマーは、自社製のファイバーレーザーを搭載し高速にクリアなトリミング跡を形成します。シャープなレーザー切削により、高信頼なトリミングが可能です。

HIPA 厚膜用レーザートリマーは、レーザーユニット・測定ユニット・制御ユニットの各ユニットの優れた機能を最大限に引き出す組み合わせにより構成されています。

- \* 独自の自社開発測定システム及び制御システムを搭載  
高精度な測定と制御を可能にしています。
- \* 高速なトリミングが可能です。(1素子のトリミング時間 10m 秒)
- \* 自社開発のトリミングソフトを使用。自由度の高いトリミングプログラムが可能です。(L字カット、ダブルカット、ILカットなど)
- \* テーブル搬送繰り返し精度 $1\mu\text{m}$ 、クランプ繰り返し精度 $10\mu\text{m}$
- \* 自社開発のファイバーレーザーを搭載。最大のコストパフォーマンスを提供します。
- \* 目的に合わせてレーザーユニットを選択できます。(IR, GREEN, UV)

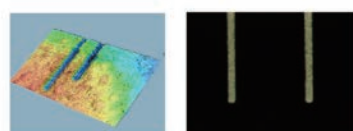
# 仕様

型番	JS-T100-TKF
適応素子サイズ	0603mm以上 (0201inch以上)
抵抗値設定範囲	0.1 Ω - 10 MΩ
抵抗値精度	1%以上(※1)
レーザー溝幅	20 ~ 30 μm
レーザー出力	20 / 30 W (IR)
ビームエキスパンダ	2 倍
フォーカス距離	125 mm
ガルバノメーター位置精度	± 1 μm
テーブル搬送位置精度	1 μm
テーブルクランプ繰返し精度	5 μm以内
測定チャンネル	192 / 240
プローブカード固定	水平調節可能

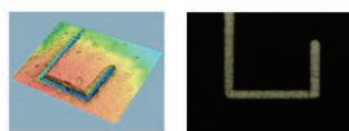


※1 トリミング精度は対象製品とトリミング方法（カット方法及びカット速度）によりかわります。 目的とする精度に合わせて調整が可能です。

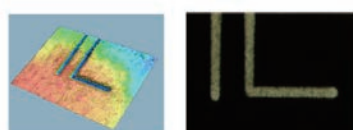
## カット例



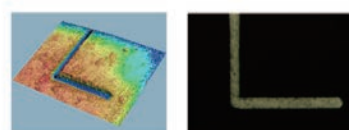
Double Cut



U Cut



IL Cut



L Cut

## システム



JPT MOPAレーザーユニット



搬送制御システム



ソフトウェアインターフェース



測定システム

仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。